# 证券代码：688693 证券简称：锴威特

**苏州锴威特半导体股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2024年第三季度业绩说明会）**

编号：2024-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | [ ] 特定对象调研 [ ] 分析师会议[ ] 媒体采访 [x] 业绩说明会[ ] 新闻发布会 [ ] 路演活动[ ] 现场参观[ ] 其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2024年11月6日(周三)下午15:30~17:00 |
| **地点** | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 丁国华董事、总经理 罗寅独立董事 秦舒董事会秘书 严泓财务总监 刘娟娟 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、锴威特在新领域或新客户的开发方面有何进展？**尊敬的投资者，您好！公司聚焦消费电子、工业控制和高可靠领域，针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域进行产品研发，同时加大市场布局和产品推广，公司凭借丰富的产品矩阵、高性能的产品和及时迅速的服务能力，实现了广泛的客户覆盖。感谢您对公司的关注！**2、面对行业内的价格战或技术替代等潜在威胁，锴威特将如何应对？**尊敬的投资者，您好！面对业内的竞争，公司进行了产品线的优化与丰富、更精准的市场定位以及新业务领域的积极探索。我们始终秉持创新发展的理念，不断加强研发实力，提升公司的核心竞争力。感谢您的关注！**3、公司的经营情况如何？**尊敬的投资者，您好！2024年前三季度，公司实现营业总收入9,249.48万元，较上年同期下降-43.37%；实现归属于母公司所有者的净利润为-3,780.95万元，较上年同期下降273.47%。公司业绩主要受行业竞争加剧、新产品新技术研发投入增加及库存减值计提增加等因素影响。感谢您的关注！**4、锴威特在新客户和新市场的开拓方面有何进展？**尊敬的投资者，您好!公司聚焦消费电子、工业控制和高可靠领域，在新能源汽车、光伏能源、轨道交通、智能电网等领域展开布局；持续加大研发投入，紧跟市场发展趋势、下游客户需求，不断拓宽产品系列。超高压平面MOSFET最高耐压已达1700V，同时具备650V-3300V SiC MOSFET设计能力；公司针对SiC功率器件的结构设计和生产工艺进行不断探索和研发投入，与国内晶圆代工厂合作开发了1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET的生产工艺平台，其中1200V SiC MOSFET工艺平台已成功进入中试阶段，新推出2600V和3300V SiC MOSFET产品。感谢您对公司的关注。**5、锴威特的核心技术是什么？**尊敬的投资者，您好！公司技术储备丰富。我们拥有多项核心技术，通过自主积累的核心技术和工艺诀窍，在超高压平面MOSFET、高压超结MOSFET、SiC MOSFET等方面已取得深厚技术积累，超高压平面MOSFET最高耐压已达1700V，同时具备650V-3300V SiC MOSFET设计能力，公司拥有较强技术水平及市场竞争力，可以满足客户多维度及多样化的产品需求。感谢您的关注！**6、公司在未来市场中的竞争优势是什么？**尊敬的投资者，您好！经过多年的技术沉淀和创新发展，公司已同时具备功率器件和功率IC的设计、研发能力，积累了多项具有原创性和先进性的核心技术。公司在市场中的竞争优势包括丰富的产品矩阵，覆盖多个细分领域；产品具备可靠性高及参数一致性好的特点，积累了多家知名客户；持续的研发投入，掌握多项核心技术；广泛的客户覆盖。感谢您对公司的关注！**7、贵公司自上市以来一直亏损，具体原因包括哪些？**尊敬的投资者，您好！公司围绕“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，持续加大产品研发和销售投入，加大市场布局和产品推广，持续提升客户服务水平，进而提升公司经营效益。公司管理层将不断加强管理能力，重视经营效率和质量，保持业务发展的韧性和持续运营能力，力争以更好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注！**8、锴威特是否有计划通过合作、并购等方式来加速市场拓展和技术创新？**尊敬的投资者，您好!公司将结合实际情况积极推动公司的价值成长，为广大投资者创造可持续的长期回报。后续公司如有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注! |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2024年11月06日 |